

第101回レーザー加工学会 講演会 (予告プログラム)

1日目 2024年12月3日(火)

第一会場 (多目的ホール)			
9:55	開会の辞	大家利彦 (奈良先端科学技術大学院大学 レーザ加工学会会長)	
10:00	ポスターショートプレゼンテーション(各2分間) + ポスタープレゼンテーション	司会: 山崎洋輔 (カナデビア(株))	
	ポスター講演	テーブルトップ展示	カタログ展示
	レーザーメタルデポジションによる超硬合金部材の補修に関する基礎検討	山口拓人 (大阪産業技術研究所)	(株)プロフィテット ブネウム(株)
	近接場光を用いた高減衰・偏光無依存ビームサンプリング技術	徳田将志 (産業技術総合研究所)	レーザーライン(株) パルステック工業(株)
	青色半導体レーザーマルチビーム金属堆積法を用いた純銅コーティングによる抗菌作用の発現	吉田環 (大阪大学)	IPGフォトリクスジャパン(株)
	16kWディスクレーザを用いた鋼板のキーホール溶接における溶融・凝固挙動の解析	池上優希 (大阪大学)	(株)タムロン 夏目光学(株) ブネウム(株) インテック(株) パルステック工業(株)
第一会場			
3A1	ベストオナー賞受賞講演	司会: 村田隆行 (川崎重工業(株))	
11:30	バイズ最適化によるき裂生成を抑制したレーザー積層造形傾斜組成超硬合金層の組成導出	山下順広 (石川工業高等専門学校, 現: 福井大学)	
12:00	カーボンニュートラルに貢献する表面改質へのレーザー応用	横田博紀 (トーカロ(株))	
昼食休憩 (12:30~13:30)			
第一会場 (多目的ホール)			
3A2	近畿高エネルギー加工技術研究所 見学	司会: 村田隆行 (川崎重工業(株))	
13:30	近畿高エネルギー加工技術研究所のご紹介	清水英樹 (近畿高エネルギー加工技術研究所)	
14:00	近畿高エネルギー加工技術研究所 設備見学	・グループ分けをして各グループ 2設備程度の見学となります。1グループの見学時間は30~40分程度となりますので、その他の時間は企業展示見学やご休憩にお当てください	
Coffee break (16:00~16:30)			
第一会場 (多目的ホール)		第二会場 (会議室1, 2, 3)	
3A3	レーザー加工装置	3B1	超短パルスレーザ加工1
	司会: 山崎洋輔 (カナデビア(株))		司会: 栗田典夫 (浜松ホトニクス(株))
16:30	ハイパワーCWレーザーによる高速高精度切断技術の確立に向けて	16:30	超短パルスレーザ駆動バブルを用いた広域材料対応型マイクロ描画プロセス
	松尾一輝 ((株)EX-Fusion)		西山宏昭 (山形大学)
17:00	超高速スキャニングシステムの紹介と加工事例	17:00	ピコ秒パルスレーザ多点集光によるガラスの微細溶接
	大串修己 (川崎重工業(株))		岡本康寛 (岡山大学)
17:30	終了		
17:30~18:00 休憩 移動			
懇親会 小ホール(18:00~20:00)			

第101回レーザー加工学会講演会 (予告プログラム)

2日目 2024年12月4日(水)

第一会場 (多目的ホール)		第二会場 (会議室1. 2. 3)	
プレナリーセッション		司会:村田隆行 (川崎重工業(株))	
10:00	【基調講演】レーザー粉末床溶融法による形状・材質制御と医療デバイスへの応用	中野貴由 (大阪大学)	
10:40	【基調講演】ファイバーレーザーのコヒーレントビーム結合	白川晃 (電気通信大学)	
昼食休憩 (11:20~12:30)			
第一会場 (多目的ホール)		第二会場 (会議室1. 2. 3)	
4A1	レーザービーム制御 司会:三瓶和久 ((株)タマリ工業)	4B1	超短パルスレーザー加工2 司会:岡本康寛 (岡山大学)
12:30	光技術による様々なレーザー加工への効果 舟木厚司 ((株)アマダ)	12:30	液相フェムト秒光渦アブレーションによる非対称マイクロ構造体創成 川口 晴生 (核融合科学研究所)
13:00	アルミニウムの新時代 ①アルミニウムとレーザー溶接 大脇桂 (一般社団法人 とやま接合技術推進協会)	13:00	空間位相・偏光制御ビームを用いた金属・半導体の微細加工 中村大輔 (九州大学)
13:30	アルミニウムの新時代 ②最先端レーザー溶接技術が実現する高品質・低ひずみ加工 大脇桂 (一般社団法人 とやま接合技術推進協会)	13:30	GHzバーストモード加工 櫻井治之 (東京大学)
14:00	狭線幅青色レーザーと波長合成技術を用いた1.7kW高輝度高出力加工用光源の実現 畠山和也 (日亜化学工業(株))	14:00	空間光位相制御技術のレーザー加工への応用展開 伊藤晴康 (浜松ホトニクス(株))
Coffee break (14:30~15:00)			
第一会場 (多目的ホール)		第二会場 (会議室1. 2. 3)	
4A2	アディティブマニュファクチャリング 司会:中村暁史(パナソニック(株))	4B2	微細加工システム 司会:栗田典夫 ((浜松ホトニクス(株))
15:00	ワイヤ・レーザー金属3Dプリンタの最新造形事例 森田大嗣 (三菱電機(株))	15:00	微細加工用レーザー加工機/光学エンジン要素技術の紹介 奥山大輔 ((株)レーザーシステム)
15:30	レーザーを使用したAMIは製品加工機となれるのか 澤越俊幸 (一般社団法人日本AM協会)	15:30	加工軌跡に応じて偏光方向を制御したレーザー四角穴加工 加藤悦史 ((株)片岡製作所)
16:00	DOEビームプロファイル制御技術を活用したレーザークラディング技術の開発 林良彦 (大阪富士工業(株))	16:00	超短パルスレーザーによる微細加工技術や事例 大竹俊介 ((株)リブスワークス)
16:30	レーザークラディングによる新規鉛フリー銅合金の創製および摺動特性の評価 渡邊健太郎 (川崎重工業(株))		
17:00	終了	16:30	終了

時間、内容に一部変更が生じる場合がありますのでご了承下さい。